

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的總覽。由於其為概要，故並不包含對閣下而言可能屬重要的所有資料。閣下決定投資[編纂]前，應細閱本文件全文。

任何投資均存在風險。投資[編纂]的部分具體風險載於本文件「風險因素」。閣下在決定投資[編纂]前，應細閱該章節。

概覽

我們是「存儲+計算+模擬」芯片提供商，我們的產品廣泛應用於汽車電子、工業醫療應用，以及AIoT及智能安防設備。

我們經營模式為無晶圓廠模式，據此，我們聚焦芯片的研發與設計，同時與領先晶圓廠及半導體封測代工（「封測代工」）公司展開合作，以確保業務可擴展性。通過內生增長與戰略收購，我們成為一家擁有全面產品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，我們在全球範圍的關鍵市場佔據領先地位，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。具體而言，以2025年收入計：

- **利基型DRAM**：在DRAM產品中，我們專注於專為對性能、可靠性或工作環境有特定要求的應用領域而設計的利基型DRAM，而不是大規模生產的標準型DRAM。我們排名全球第七，於總部位於中國大陸的公司中排名第二。
- **SRAM**：我們排名全球第二，於總部位於中國大陸的公司中排名第一。
- **NOR Flash**：我們的Flash存儲芯片產品線包括NOR Flash及NAND Flash。NOR Flash經過優化以適用於快速、可靠的代碼執行。我們排名全球第七，於總部位於中國大陸的公司中排名第三。
- **IP-Cam SoC**：我們的智能視覺SoC產品線主要包括IP-Cam SoC、圖像信號處理器（「ISP」）及網絡視頻錄像機（「NVR」）SoC，而IP-Cam SoC集成ISP、視頻編碼等關鍵功能，以為網絡攝像機提供一體化算力。我們在全球IP-Cam SoC供應商中排名第二。

我們的業務方針

我們提供結合芯片、硬件、軟件、工具鏈及算法的產品，以服務多種應用場景。我們業務方針的核心是涵蓋三大產品線的全面產品組合：存儲、計算及模擬芯片。

概 要

我們的產品

我們的產品組合涵蓋三大產品線：存儲芯片、計算芯片及模擬芯片。經過多年的積累與創新，我們已開發出主要應用於汽車電子及工業醫療的存儲芯片（包括**DRAM**、**SRAM**、**NOR Flash**及**NAND Flash**），應用於AIoT及安防的計算芯片，應用於汽車電子、工業及家電的模擬芯片（包括**LED**驅動芯片及**Combo**芯片）。我們的產品符合車規級及工業級標準，具備高品質、高可靠性、低能耗及產品壽命長的特點。

存儲芯片

我們的存儲芯片產品線包括**DRAM**、**SRAM**、**NOR Flash**及**NAND Flash**，旨在滿足汽車電子及工業醫療領域的嚴苛要求。對於汽車領域，該等要求包括在車規級生產、篩選及變更控制流程的基礎上實現寬溫及寬濕等級、長期供應及生命週期支持、更強的數據保持能力及耐久性、較低的可接受缺陷率。該系列產品專為在嚴苛工作環境下實現高性能、高可靠性及高能效而設計。

計算芯片

我們的計算芯片產品線包括一系列基於我們自研核心計算單元的**SoC**，例如中央處理器（「**CPU**」）、視覺處理單元（「**VPU**」）、神經處理單元（「**NPU**」）、圖像信號處理器及人工智能圖像信號處理器（「**AI-ISP**」）。該等產品涵蓋三個子產品線：智能視覺**SoC**、嵌入式**MPU**及**AI-MCU**。該等產品旨在實現高性能及低功耗，滿足各種設備不斷變化的需求，主要包括安防攝像頭、門鈴、**AR**眼鏡、掃地機器人、二維碼／條形碼識別及人臉和指紋識別應用。我們亦正在採用**RISC-V**（為一種開放標準精簡指令集計算機架構）作為我們計算芯片的主要架構，充分利用其開放性及靈活性，以進一步加強我們的技術競爭力。

截至最後實際可行日期，我們已完成多項目晶圓（「**MPW**」）的工程樣品驗證測試，並完成了**AI-MCU**的全掩膜樣本驗證。

模擬芯片

我們為汽車電子、工業及家電設計模擬芯片，應用於照明、觸控、聲控、電源與控制應用領域。我們亦提供多功能**Combo**芯片，將微控制器單元（「**MCU**」）、**LED**驅動器、電源管理及通信接口（如控制器局域網（「**CAN**」）或局部連接網絡（「**LIN**」））集成到單一芯片。

研發

研發對維持我們的競爭地位及推動業務長期增長至關重要，使我們能夠滿足下游應用不斷變化的需求。我們已實施集成產品開發（「**IPD**」）框架，即系統性的研發管理模式，將產品開發視為一項戰略投資決策。該框架以市場需求為支撐，透過跨部門

概 要

協作以實現商業成功，將我們的產品業務線整合為一個連貫的研發流程。請參閱「業務－研發」。

我們的研發聚焦於產品核心IP自主開發，同時策略性地整合成熟授權IP，增強技術能力並優化產品性能。

銷售及營銷

我們的產品銷往亞洲、美洲及歐洲約50個國家和地區的下游客戶。我們組建了一支由銷售及營銷專業人員以及工程師組成的國際化團隊，為我們的銷售及服務網絡提供本地化支持。該團隊擅長獲取市場實時動態並據此採取行動，確保及時有效地響應客戶需求。

下表載列於往績記錄期間經銷商及直銷產生的收入。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
經銷										
購銷.....	3,143,088	69.4%	2,940,396	69.8%	3,436,650	72.4%	737,672	69.6%	1,153,578	74.0%
代銷.....	421,405	9.3%	338,185	8.0%	334,567	7.1%	79,556	7.5%	110,998	7.1%
經銷小計...	3,564,493	78.7%	3,278,581	77.8%	3,771,217	79.5%	817,228	77.1%	1,264,576	81.1%
直銷.....	966,433	21.3%	934,045	22.2%	969,791	20.5%	243,004	22.9%	295,191	18.9%
總計.....	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%

客戶及供應商

我們的客戶

我們的客戶為經銷商及直銷客戶，主要包括電子元件製造商及銷售商。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向五大客戶的銷售額分別為人民幣2,470.4百萬元、人民幣2,187.6百萬元、人民幣2,406.0百萬元及人民幣784.9百萬元，分別佔我們於各期間總銷售額的54.5%、51.9%、50.7%及50.3%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向最大客戶的銷售額分別為人民幣953.7百萬元、人民幣817.3百萬元、人民幣812.5百萬元及人民幣243.2百萬元，分別佔我們於各期間總銷售額的21.0%、19.4%、17.1%及15.6%。

我們的供應商

我們的供應商主要為進行芯片製造的晶圓廠合作夥伴以及進行芯片測試及封裝的封測代工合作夥伴。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向五大供應商的採購額分別為人民幣1,701.0百萬元、人民幣1,423.3百萬元、人民幣1,555.1百萬元及人民幣430.4百萬元，分別佔我們於各期間總採購額

概 要

的58.3%、47.8%、45.1%及41.6%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向最大供應商的採購額分別為人民幣773.9百萬元、人民幣350.4百萬元、人民幣479.7百萬元及人民幣126.6百萬元，分別佔我們於各期間總採購額的26.5%、11.8%、13.9%及12.3%。

我們的競爭優勢

我們認為以下優勢令我們可把握未來行業機遇及實現持續增長：

- 「存儲+計算+模擬」芯片提供商；
- 多項自主研發的核心技術；
- 通過核心技術要素整合的產品組合；
- 強大的供應鏈和質量管理體系；
- 兼具屬地化服務的國際銷售網絡；及
- 跨文化協同的國際化人才團隊。

我們的發展戰略

我們致力成為一家世界一流科技公司。為達到該目標，我們將實施以下戰略：

- 強化技術與產品佈局；
- 深化車規芯片產品升級與矩陣拓展；
- 強化銷售網絡；
- 沿產業鏈尋求側重性投資併購；及
- 加強人才資源配置。

競爭

我們經營所在市場競爭激烈，且我們與其他芯片提供商競爭。競爭格局由多種因素形成，包括客戶及其各自行業的發展、技術進步、新材料或技術的出現、產能、監管變動及整體經濟狀況。可能會出現新的市場參與者，推出對現有參與者構成挑戰的創新性或具成本效益的產品。倘我們未能緊跟有關進步或未能在質量或成本方面使我們的產品脫穎而出，則我們面臨市場份額流失至競爭對手的風險。

歷史財務資料概要

下表載列我們於往績記錄期間的綜合財務資料的財務數據概要。下文所載財務數據概要應與本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表（包括相關附註）一併閱讀，並受該等報表全文限制。我們的綜合財務資料乃根據國際財務報告準則會計準則編製。

概 要

經營業績

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
收入.....	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%
銷售成本.....	(2,922,894)	(64.5)%	(2,739,501)	(65.0)%	(3,186,442)	(67.2)%	(689,166)	(65.0)%	(895,696)	(57.4)%
毛利.....	1,608,032	35.5%	1,473,125	35.0%	1,554,566	32.8%	371,066	35.0%	664,071	42.6%
其他收入、收益及										
虧損淨額.....	149,868	3.3%	139,931	3.3%	176,666	3.7%	29,867	2.8%	24,358	1.6%
銷售及經銷開支..	(323,145)	(7.1)%	(303,206)	(7.2)%	(332,961)	(7.0)%	(81,933)	(7.7)%	(95,530)	(6.1)%
行政開支.....	(180,155)	(4.0)%	(217,108)	(5.2)%	(271,956)	(5.7)%	(58,364)	(5.5)%	(57,264)	(3.7)%
研發開支.....	(708,345)	(15.6)%	(681,339)	(16.2)%	(712,027)	(15.0)%	(176,327)	(16.6)%	(171,903)	(11.0)%
財務成本.....	(142)	(0.0)%	(1,083)	(0.0)%	(866)	(0.0)%	(213)	(0.0)%	(198)	(0.0)%
分佔聯營										
公司業績.....	(909)	(0.0)%	(355)	(0.0)%	258	0.0%	(45)	(0.0)%	(22)	(0.0)%
除稅前利潤.....	545,204	12.0%	409,965	9.7%	413,680	8.7%	84,051	7.9%	363,512	23.3%
所得稅開支.....	(29,480)	(0.7)%	(45,767)	(1.1)%	(38,349)	(0.8)%	(10,376)	(1.0)%	(43,164)	(2.8)%
年／期內利潤....	<u>515,724</u>	<u>11.4%</u>	<u>364,198</u>	<u>8.6%</u>	<u>375,331</u>	<u>7.9%</u>	<u>73,675</u>	<u>6.9%</u>	<u>320,348</u>	<u>20.5%</u>

非國際財務報告準則計量

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦使用年／期內經調整利潤（非國際財務報告準則計量）及經調整淨利率（非國際財務報告準則計量），作為額外財務計量，該等計量並非國際財務報告準則所規定，亦非根據國際財務報告準則呈列。我們相信，該等非國際財務報告準則計量通過消除若干項目的潛在影響，有助於比較各期間的經營表現。我們相信，該等計量按其協助我們管理層所採用之相同方式為投資者及其他人士理解及評估我們的綜合財務報表提供了有用的資料。然而，我們呈列的年／期內經調整利潤（非國際財務報告準則計量）及經調整淨利率（非國際財務報告準則計量）可能無法與其他公司呈列的類似計量進行比較。使用該等非國際財務報告準則計量作為分析工具存在局限性，閣下不應將其與我們根據國際財務報告準則呈報的綜合財務報表或財務狀況分開來考慮，也不應將其視為根據國際財務報告準則呈報的綜合財務報表或財務狀況的替代分析。我們將年／期內經調整利潤（非國際財務報告準則計量）定義為就[編纂]開支及以股份為基礎的薪酬（非現金項目）作出調整的年內利潤。我們將經調整淨利率（非國際財務報告準則計量）定義為年／期內經調整利潤（非國際財務報告準則計量）佔我們收入的百分比。

概 要

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
(人民幣千元，百分比除外)					
(未經審計)					
年／期內利潤.....	515,724	364,198	375,331	73,675	320,348
加：					
[編纂]開支.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
以股份為基礎的薪酬.....	—	45,128	54,553	11,892	7,264
年／期內經調整利潤(非國際財務報告準則計量).....	515,724	409,326	431,077	85,567	327,702
經調整淨利率(非國際財務報告準則計量).....	11.4%	9.7%	9.1%	8.1%	21.0%

收入

於往績記錄期間，我們主要自銷售存儲芯片、計算芯片及模擬芯片產生收入。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
(人民幣千元，百分比除外)										
(未經審計)										
存儲芯片										
DRAM	1,590,161	35.1%	1,328,242	31.5%	1,414,456	29.8%	338,247	31.9%	522,348	33.5%
Flash.....	868,836	19.2%	883,461	21.0%	1,095,127	23.1%	231,991	21.9%	372,613	23.9%
SRAM	452,561	10.0%	377,789	9.0%	401,671	8.5%	92,317	8.7%	122,909	7.9%
小計.....	2,911,558	64.3%	2,589,492	61.5%	2,911,254	61.4%	662,555	62.5%	1,017,870	65.3%
計算芯片										
智能視覺SoC....	945,450	20.9%	906,385	21.5%	997,410	21.1%	216,836	20.5%	308,200	19.7%
嵌入式MPU	162,921	3.6%	183,719	4.4%	296,001	6.2%	53,270	5.0%	94,507	6.1%
小計.....	1,108,371	24.5%	1,090,104	25.9%	1,293,411	27.3%	270,106	25.5%	402,707	25.8%
模擬芯片										
LED驅動芯片....	393,214	8.7%	450,874	10.7%	484,889	10.3%	113,268	10.6%	128,214	8.2%
Combo芯片	15,704	0.3%	20,648	0.5%	20,750	0.4%	6,001	0.6%	4,200	0.3%
小計.....	408,918	9.0%	471,522	11.2%	505,639	10.7%	119,269	11.2%	132,414	8.5%
其他 ⁽¹⁾	102,079	2.3%	61,508	1.5%	30,704	0.6%	8,302	0.8%	6,776	0.4%
總計.....	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%

附註：

(1) 主要包括銷售其他商品(包括開發板)、提供技術服務及租賃收入。

概 要

我們的總收入由2023年的人民幣4,530.9百萬元減至2024年的人民幣4,212.6百萬元，主要由於存儲芯片銷售收入減少。我們的總收入增至2025年的人民幣4,741.0百萬元，主要由於存儲芯片及計算芯片銷售收入增加。於截至2025年3月31日止三個月至2026年同期，總收入由人民幣1,060.2百萬元增至人民幣1,559.8百萬元，乃主要由於銷售存儲芯片及計算芯片的收入增加。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	銷量 (千顆)	平均 售價 ⁽¹⁾ (人民幣元)	銷量 (千顆)	平均 售價 ⁽¹⁾ (人民幣元)	銷量 (千顆)	平均 售價 ⁽¹⁾ (人民幣元)	銷量 (千顆)	平均 售價 ⁽¹⁾ (人民幣元)	銷量 (千顆)	平均 售價 ⁽¹⁾ (人民幣元)
存儲芯片	415,932	7.0	479,042	5.4	602,424	4.8	137,678	4.8	191,036	5.3
計算芯片	75,503	14.7	93,526	11.7	120,868	10.7	23,739	11.4	26,632	15.1
模擬芯片	179,356	2.3	217,335	2.2	250,252	2.0	56,748	2.1	64,340	2.1

附註：

(1) 平均售價乃按收入除以同年／期的相關銷量計算，即我們向客戶銷售產品的平均價格。

存儲芯片

- 收入趨勢。**存儲芯片銷售收入由2023年的人民幣2,911.6百萬元減至2024年的人民幣2,589.5百萬元，並增至2025年的人民幣2,911.3百萬元，其後由截至2025年3月31日止三個月的人民幣662.6百萬元增至2026年同期的人民幣1,017.9百萬元。銷量由2023年的415.9百萬顆增至2024年的479.0百萬顆及2025年的602.4百萬顆，並由截至2025年3月31日止三個月的137.7百萬顆增至2026年同期的191.0百萬顆。於2023年、2024年及2025年，平均售價分別為每顆人民幣7.0元、每顆人民幣5.4元及每顆人民幣4.8元。按中期基準，平均售價由截至2025年3月31日止三個月的每顆人民幣4.8元增至2026年同期的每顆人民幣5.3元。
- 收入波動。**我們的存儲芯片主要用於汽車及工業醫療應用。該等終端市場的趨勢，連同DRAM內產品組合轉變、我們能夠提供的產品組合及我們從晶圓廠合作夥伴獲得的有限產能（產能於2025年下半年開始收緊並自此延續緊張態勢）以及經過行業低迷後終端市場需求反彈並於2024年不斷上升，均是我們存儲芯片銷售收入波動的主要原因。截至2026年3月31日止三個月的收入、銷量及平均售價較2025年同期增加乃主要由於對存儲芯片產品的需求強勁。請參閱「財務資料－影響我們經營業績的重大因素－行業週期」。
- 產品里程碑。**由於近年來我們尚未獲得高密度LPDDR4產品的合適工藝節點，故其量產啟動時間晚於主流市場需求變動，從而限制了我們把握該期間增長機遇的能力。於2025年，我們的1x-nm高密度LPDDR4產品已送樣，且於2025年下半年開始銷售爬坡，其中若干器件正處於早期規模化階

概 要

段，預計將主要為汽車應用場景帶來可觀銷售。截至2026年3月31日止三個月，我們的1x-nm高密度LPDDR4產品進入量產階段，且已開始大規模銷售。截至最後實際可行日期，LPDDR5正在規劃中。

計算芯片

- **收入趨勢。**計算芯片銷售收入由2023年的人民幣1,108.4百萬元減至2024年的人民幣1,090.1百萬元，並增至2025年的人民幣1,293.4百萬元，其後由截至2025年3月31日止三個月的人民幣270.1百萬元增至2026年同期的人民幣402.7百萬元。銷量由2023年的75.5百萬顆增至2024年的93.5百萬顆及2025年的120.9百萬顆，並由截至2025年3月31日止三個月的23.7百萬顆增至2026年同期的26.6百萬顆。平均售價由2023年的每顆人民幣14.7元減至2024年的每顆人民幣11.7元，並進一步減至2025年的每顆人民幣10.7元。按中期基準，平均售價由截至2025年3月31日止三個月的每顆人民幣11.4元增至2026年同期的每顆人民幣15.1元。
- **收入波動。**我們的計算芯片主要用於消費應用領域，包括安防及AIoT。於往績記錄期間，我們計算芯片的終端市場經歷短週期。於2024年，儘管銷量持續增長，但由於競爭加劇及消費降級壓低平均售價，導致收入有所下降。於2025年，在市況改善以及對我們計算芯片產品的持續需求支撐下，收入及銷量均實現回升。截至2026年3月31日止三個月的收入較2025年同期增加乃主要由於良品晶粒（「KGD」）等關鍵原材料短缺及由此引致的價格上漲，而此令計算芯片的供應緊張並推高其售價。有關短缺及價格上漲乃主要由於對AI驅動應用的需求激增，且在業內上游產能有限的背景下，推動了上游供應商重新分配產能至用於AI相關芯片的原材料，擠佔了包括我們計算芯片在內的其他應用的供應。

與2025年同期相比，截至2026年3月31日止三個月我們計算芯片的毛利率亦有所提高。此乃主要由於我們計算芯片的平均售價增幅超過同期單位銷售成本的增幅。儘管KGD等關鍵原材料的短缺提高了我們的採購成本，但我們於期內出售的絕大部分計算芯片乃使用我們於價格上漲前已採購並於存有的原材料進行生產，因此我們能夠在自身銷售成本相應增加前將較高的市價轉嫁予我們的客戶。因此，關鍵原材料的短缺及由此導致的價格上升於期內對我們售價造成的積極影響大於對銷售成本造成的影響，提高了我們計算芯片的毛利率。

概 要

模擬芯片

- 收入趨勢。**模擬芯片銷售收入由2023年的人民幣408.9百萬元增至2024年的人民幣471.5百萬元及2025年的人民幣505.6百萬元，其後由截至2025年3月31日止三個月的人民幣119.3百萬元增至2026年同期的人民幣132.4百萬元。銷量由2023年的179.4百萬顆增至2024年的217.3百萬顆及2025年的250.3百萬顆，並由截至2025年3月31日止三個月的56.7百萬顆增至2026年同期的64.3百萬顆。平均售價由2023年的每顆人民幣2.3元降至2024年的每顆人民幣2.2元及2025年的每顆人民幣2.0元。按中期基準，截至2025年3月31日止三個月及2026年同期平均售價保持穩定，均為每顆人民幣2.1元。
- 收入波動。**我們的模擬芯片主要用於汽車應用領域，於消費市場佔比較小。2023年因為汽車市場下行周期，因此收入下降，2024年、2025年隨著新產品的推出和市場的逐漸恢復，收入持續增長，2025年以來呈復甦跡象。有關行業趨勢以及產品系列持續擴充推動往績記錄期間我們的銷量及收入增長。截至2026年3月31日止三個月的收入較2025年同期增加乃主要由於汽車電子領域的需求更強勁，此乃得益於汽車照明的市場需求增加及汽車智能系統的發展，共同促使我們車規級模擬芯片的採購量相應增加。

下表載列按下游應用劃分的收入進一步明細。詳情請參閱「財務資料－經營業績的主要組成部分－按應用場景」。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
汽車⁽¹⁾										
存儲芯片	1,435,892	31.7%	1,269,123	30.1%	1,341,264	28.3%	303,847	28.7%	453,450	29.1%
模擬芯片	175,321	3.9%	222,467	5.3%	247,191	5.2%	62,992	5.9%	61,620	4.0%
小計	1,611,213	35.6%	1,491,590	35.4%	1,588,455	33.5%	366,839	34.6%	515,070	33.0%
工業醫療⁽¹⁾										
存儲芯片	1,007,221	22.2%	856,640	20.3%	1,022,397	21.6%	231,072	21.8%	357,175	22.9%
模擬芯片	95,266	2.1%	88,987	2.1%	96,362	2.0%	22,678	2.1%	25,223	1.6%
小計	1,102,487	24.3%	945,627	22.4%	1,118,759	23.6%	253,750	23.9%	382,398	24.5%
消費⁽¹⁾										
存儲芯片	233,913	5.2%	205,405	4.9%	238,530	5.0%	52,632	5.0%	91,134	5.8%
計算芯片	1,108,371	24.5%	1,090,104	25.9%	1,293,411	27.3%	270,106	25.5%	402,707	25.8%
模擬芯片	126,322	2.8%	142,411	3.4%	132,511	2.8%	29,730	2.8%	30,678	2.0%
小計	1,468,606	32.4%	1,437,920	34.1%	1,664,452	35.1%	352,468	33.3%	524,519	33.6%
其他應用場景⁽¹⁾⁽²⁾										
存儲芯片	234,532	5.2%	258,324	6.1%	309,063	6.5%	75,004	7.1%	116,111	7.4%
模擬芯片	12,009	0.3%	17,657	0.4%	29,575	0.6%	3,869	0.4%	14,893	1.0%
小計	246,541	5.4%	275,981	6.6%	338,638	7.1%	78,873	7.4%	131,004	8.4%
其他 ⁽³⁾	102,079	2.3%	61,508	1.5%	30,704	0.7%	8,302	0.8%	6,776	0.5%
總計	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%

概 要

附註：

- (1) 我們主要根據產品的應用級別按下游應用呈列收入。儘管各應用級別主要為其相應終端用途而設計，但客戶可能將同一級別部署於不同場景（例如，若干消費級產品可能用於質量或可靠性要求較低的汽車領域，而車規級產品有時因生命週期或資質原因而獲非汽車平台採用）。
- (2) 主要包括通信應用，指我們的芯片在通信與網絡設備及基礎設施的終端市場使用場景。
- (3) 主要包括銷售其他商品（包括開發板）、提供技術服務及租賃收入。

毛利及毛利率

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率 ⁽¹⁾
(人民幣千元，百分比除外)										
(未經審計)										
存儲芯片	1,000,369	34.4%	833,930	32.2%	872,650	30.0%	216,986	32.7%	381,807	37.5%
計算芯片	299,620	27.0%	358,076	32.8%	398,052	30.8%	87,847	32.5%	209,020	51.9%
模擬芯片	208,925	51.1%	222,390	47.2%	255,469	50.5%	58,527	49.1%	67,118	50.7%
其他.....	99,118	97.1%	58,729	95.5%	28,395	92.5%	7,706	92.8%	6,126	90.4%
總計／總體 ⁽¹⁾	<u>1,608,032</u>	<u>35.5%</u>	<u>1,473,125</u>	<u>35.0%</u>	<u>1,554,566</u>	<u>32.8%</u>	<u>371,066</u>	<u>35.0%</u>	<u>664,071</u>	<u>42.6%</u>

附註：

- (1) 毛利率乃按年／期內毛利除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。

我們的毛利由截至2025年3月31日止三個月的人民幣371.1百萬元增加79.0%至2026年同期的人民幣664.1百萬元，乃主要由於我們的收入增加及我們的毛利率由截至2025年3月31日止三個月的35.0%增至2026年同期的42.6%。我們的毛利由2024年的人民幣1,473.1百萬元增加5.5%至2025年的人民幣1,554.6百萬元，乃主要由於收入增加，部分被毛利率由2024年的35.0%減至2025年的32.8%所抵銷。我們的毛利由2023年的人民幣1,608.0百萬元減少8.4%至2024年的人民幣1,473.1百萬元，乃主要由於收入減少。毛利率於2023年及2024年維持相對穩定，分別為35.5%及35.0%，並進一步下降至2025年的32.8%。截至2025年及2026年3月31日止三個月，我們的毛利率由35.0%增至42.6%。然而，2023年及2024年我們的整體毛利率保持相對穩定，分別為35.5%及35.0%，之後降至2025年的32.8%。在此期間我們的毛利率相對具韌性，因為儘管受市場因素推動，我們平均售價下跌，但我們的晶圓成本整體上呈相同趨勢且幅度相若，有助於抵銷定價壓力及穩定我們的毛利率。截至2026年3月31日止三個月的毛利及毛利率提高乃主要由於受市場對存儲芯片及計算芯片的需求激增推動平均售價上漲。亦請參閱「財務資料—經營業績的主要組成部分—毛利及毛利率」。

概 要

計劃提升我們的盈利能力

我們計劃通過協調推進收入增長、成本優化及開支管控等多項舉措以提升我們的盈利能力。請參閱「財務資料－經營業績－計劃提升我們的盈利能力」。

淨利潤

我們的期內利潤由截至2025年3月31日止三個月的人民幣73.7百萬元增加334.6%至2026年同期的人民幣320.3百萬元，乃主要由於收入增加，以及淨利潤率由截至2025年3月31日止三個月的6.9%增長至2026年同期的20.5%。我們的淨利潤及淨利潤率增加乃主要由於收入由人民幣1,060.2百萬元增加至人民幣1,559.8百萬元以及毛利率由35.0%提高至42.6%，主要歸因於我們的存儲芯片及計算芯片，以及研發開支對收入的佔比下降（其由16.6%下降至11.0%），因為收入增幅高於有關開支的增幅。

我們的年內利潤由2024年的人民幣364.2百萬元增加3.1%至2025年的人民幣375.3百萬元，乃主要由於收入由人民幣4,212.6百萬元增加至人民幣4,741.0百萬元，部分被淨利潤率由2024年的8.6%下降至2025年的7.9%所抵銷。淨利潤率下降乃主要由於銷售成本增幅超過收入增幅，令毛利率由35.0%下降至32.8%，同時行政開支佔收入的百分比上升。

我們的年內利潤由2023年的人民幣515.7百萬元減少29.4%至2024年的人民幣364.2百萬元，乃主要由於收入由人民幣4,530.9百萬元減少至人民幣4,212.6百萬元，以及淨利潤率由2023年的11.4%下降至2024年的8.6%。因此，我們的淨利潤減少反映收入減少及利潤率收窄，原因是毛利率下降及行政開支佔收入的百分比由4.0%上升至5.2%，惟部分被研發開支略微減少所抵銷。

綜合財務狀況表概要

	截至12月31日			截至3月31日
	2023年	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			
非流動資產.....	5,159,014	4,878,490	4,879,847	4,949,007
流動資產.....	7,583,012	8,048,454	8,693,358	8,877,728
流動負債.....	784,596	738,109	999,978	979,435
流動資產淨值.....	6,798,416	7,310,345	7,693,380	7,898,293
資產總值減流動負債.....	11,957,430	12,188,835	12,573,227	12,847,300
非流動負債.....	127,907	105,922	84,311	90,897
資產淨值.....	11,829,523	12,082,913	12,488,916	12,756,403
非控股權益.....	38,300	28,988	40,058	40,916

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣6,798.4百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣7,310.3百萬元，乃主要由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加，部分被貿易應收款項及應收票據增加所抵銷。截至2025年12月31日，我們的流動資產淨值進一步增加至人民幣7,693.4百萬元，乃主要由於存貨及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加，部分被貿易及其他應

概 要

付款項增加所抵銷。截至2026年3月31日，我們的流動資產淨值進一步增加至人民幣7,898.3百萬元，乃主要由於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加，部分被銀行結餘及現金減少所抵銷。

我們的資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣11,829.5百萬元增至截至2024年12月31日的人民幣12,082.9百萬元，乃主要由於(i)年內利潤人民幣364.2百萬元及(ii)以權益結算以股份為基礎的薪酬開支人民幣45.1百萬元，部分被(iii)確認為分派的股息人民幣96.3百萬元及(iv)其他全面開支人民幣59.6百萬元所抵銷，而有關開支乃主要由於我們的匯兌儲備及公允價值儲備不利變動而產生。

我們的資產淨值增至截至2025年12月31日的人民幣12,488.9百萬元，乃主要由於(i)年內利潤人民幣375.3百萬元；(ii)一家附屬公司的非控股權益注資人民幣39.9百萬元；(iii)已發行股份人民幣30.0百萬元；及(iv)以權益結算以股份為基礎的薪酬開支人民幣54.6百萬元，部分被(v)確認為分派的股息人民幣48.2百萬元及(vi)其他全面開支人民幣45.7百萬元所抵銷。

我們的資產淨值增至截至2026年3月31日的人民幣12,756.4百萬元，乃主要由於(i)期內利潤人民幣320.3百萬元及(ii)以權益結算以股份為基礎的薪酬開支人民幣7.3百萬元，部分被(iii)其他全面開支人民幣60.1百萬元所抵銷，而有關開支乃主要由於我們的匯兌儲備的不利變動而產生，部分被我們公允價值儲備的有利變動所抵銷。

現金流量

下表載列我們於所示年度／期間的現金流量。

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			(未經審計)	
經營活動所得現金淨額	558,152	363,455	622,603	175,150	216,689
投資活動所用現金淨額	(14,213)	(413,205)	(233,657)	(616,217)	(732,039)
融資活動所用現金淨額	(32,770)	(106,806)	(7,248)	(2,846)	(4,573)
現金及現金等價物					
增加／(減少)淨額	511,169	(156,556)	381,698	(443,913)	(519,923)
年／期初現金及現金等價物 ..	3,398,066	3,924,646	3,711,868	3,711,868	4,087,149
外匯匯率變動的影響	15,411	(56,222)	(6,417)	(9,985)	(155,487)
年／期末現金及現金等價物 ..	<u>3,924,646</u>	<u>3,711,868</u>	<u>4,087,149</u>	<u>3,257,970</u>	<u>3,411,739</u>

概 要

於往績記錄期間，我們的現金周轉週期受存貨周轉天數影響。存貨周轉天數由2023年的294天增加至2024年的338天。該增加主要受以下因素推動：(i)在行業下行週期期間供過於求，導致終端銷售放緩；(ii)在晶圓價格相對較低時進行戰略性存貨積累，以確保成本及供應優勢；及(iii)根據與晶圓廠的長期安排進行保障產能的採購，這影響晶圓交付的時機並推高了平均存貨水平。於2025年，由於我們開始實施多項存貨管理措施，我們的存貨周轉天數減至323天。我們的存貨周轉天數進一步減至截至2026年3月31日止三個月的297天，乃由於我們的存貨管理措施以及對我們芯片產品的強勁需求，共同加速了存貨周轉。請參閱「財務資料－選定資產負債表項目－存貨」。

主要財務比率

	截至12月31日止年度／截至12月31日			截至3月31日 止三個月／ 截至3月31日
	2023年	2024年	2025年	2026年
毛利率(%) ⁽¹⁾	35.5	35.0	32.8	42.6
淨利率(%) ⁽²⁾	11.4	8.6	7.9	20.5
經調整淨利率 (非國際財務報告 準則計量)(%) ⁽³⁾	11.4	9.7	9.1	21.0
流動比率 ⁽⁴⁾	9.7	10.9	8.7	9.1

附註：

- (1) 毛利率按年／期內毛利除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。
- (2) 淨利率按年／期內淨利潤除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。
- (3) 經調整淨利率(非國際財務報告準則計量)乃按年／期內經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)乃按自「非國際財務報告準則計量」所界定的年／期內利潤中剔除[編纂]開支及以股份為基礎的薪酬計算。
- (4) 流動比率乃按截至相關年／期末的流動資產除以流動負債計算。

[編纂]開支

[編纂]開支指就[編纂]及[編纂]產生的專業費用、[編纂]佣金及費用。假設最高[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，我們的[編纂]開支估計約為[編纂]港元(包括[編纂]佣金)，佔[編纂][編纂]總額約[編纂]%。於我們的[編纂]開支中，約[編纂]港元直接歸因於發行股份，並將於[編纂]完成後自權益扣除，而約[編纂]港元已經或將自我們的綜合全面收益表扣除。我們於往績記錄期間產生及預期將產生的[編纂]開支中，約[編纂]港元為[編纂]相關開支及費用(包括[編纂]佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)、約[編纂]港元為非[編纂]相關開支及費用(包括獨家保薦人、法律顧問及申報會計師的費用)，以及約[編纂]港元為其他非[編纂]相關費用及開支。於往績記錄期間，我們產生[編纂]開支約[編纂]港元。

上述[編纂]開支為最新實際可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有所不同。

概 要

風險因素

我們面臨的風險包括「風險因素」一節所載者。由於不同投資者釐定風險重大性時可能有不同詮釋及標準，閣下於決定投資H股前應細閱「風險因素」一節全文。我們面臨的若干主要風險包括：

- 若我們未能妥善預測或應對不斷變化的市場環境，或未能及時研發並推出新產品或升級產品，我們吸引及留住客戶的能力可能會受損，競爭地位亦可能會受到不利影響。
- 我們的業績受到採用我們產品的下游行業需求以及終端產品價格波動的影響。
- 我們經營所處行業歷來具有週期性特徵，並已經歷平均售價下跌的低迷期。
- 我們的大部分收入來自少數客戶。流失一名或多名有關客戶或其採購額大幅減少均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
- 我們通過經銷商進行銷售增加了我們業務的複雜性，且可能會降低我們預測收入的能力。

未來計劃及[編纂]用途

假設最高[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，我們估計扣除與[編纂]相關的[編纂]佣金及其他估計開支後（假設[編纂]未獲行使），我們將從[編纂]中獲得約[編纂]港元的[編纂]淨額。我們計劃將[編纂]按以下金額用於下列用途。

- 約[編纂]%（即[編纂]港元）將用於加強我們三大核心業務板塊的技術創新和產品開發；
- 約[編纂]%（即[編纂]港元）將用於戰略投資及／或收購，以把握增長機遇；
- 約[編纂]%（即[編纂]港元）將用於擴展我們的銷售網絡並推廣我們的產品；及
- 約[編纂]%（即[編纂]港元）將用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營和一般公司支出。

概 要

[編纂]統計數據

基於最高[編纂]每股 H股[編纂]港元計算

H股的市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元
本公司總市值 ⁽²⁾	[編纂]港元
每股未經審計[編纂]經調整有形資產淨值 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	[編纂]港元

附註：

- (1) H股的市值乃基於緊隨[編纂]完成後預期將發行的[編纂]股H股計算（假設[編纂]未獲行使）。
- (2) 本公司的市值乃基於截至最後實際可行日期已發行483,664,367股A股及緊隨[編纂]完成後預期將發行的[編纂]股H股計算（假設[編纂]未獲行使）。A股市值乃基於緊接最後實際可行日期前五個營業日A股的平均收市價每股A股人民幣129.02元計算。
- (3) 每股未經審計[編纂]經調整有形資產淨值乃於作出本文件「附錄二A－未經審計[編纂]財務資料」所述調整後達致。計算每股未經審計[編纂]經調整有形資產淨值所採用的A股數目與附註2所載計算本公司市值所採用的A股數目有所不同，該差異乃因先前根據2024年限制性股票激勵計劃授出的1,123,644股限制性股份於2026年6月8日獲歸屬所致。
- (4) 概無作出任何調整以反映本集團於2026年3月31日後的任何交易結果或所訂立的其他交易。
- (5) 如本公司已考慮於2026年3月31日批准及派付2025年末期股息約人民幣72,381,000元，按[編纂]每股股份[編纂]港元計，本公司擁有人應佔本集團每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值將為[編纂]港元。

股息政策

根據中國的法律法規（包括《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號－上市公司現金分紅（2025年修訂）》）以及公司章程，且在符合現金股息分派的條件的前提下，我們須每年以現金股息的形式分派不少於5%的母公司於相關財政年度應佔可分派利潤。此外，於任何連續三年期間，分配的現金股息總額不得低於公司於該三年期間實現的年均可分派利潤的30%。除《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號－上市公司現金分紅（2025年修訂）》項下的上述法定規定外，我們並無任何其他正式股息政策或預定股息分派率。

我們通常於股東週年大會審閱及釐定年度利潤分派方案。以2024年度利潤分派方案為例，於2025年5月12日，我們召開2024年股東週年大會，於會上審議批准「2024年度利潤分派方案」。根據該方案，於2025年6月，我們基於截至該日的股本總數482,540,723股股份向全體股東分派現金股息每10股股份人民幣0.997988元（含稅）。於2026年5月7日，我們召開2025年股東週年大會，於會上審議批准「2025

概 要

年度利潤分配方案」。根據該方案，於2026年5月，我們基於截至該日的股本總數482,540,723股股份向全體股東分派現金股息每10股股份人民幣1.5元（含稅）。

於往績記錄期間，我們宣派股息如下：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			
年／期內應佔股息	38,527	96,314	48,156	—

未來的利潤分配可以現金股息或股票股息的形式，或可以現金股息及股票股息相結合的形式進行。任何股息的擬議分派均須經董事會酌情決定，並須經股東會批准。未來董事會可能會在考慮我們的經營業績、財務狀況、運營要求、資本要求、股東利益以及董事會可能認為相關的任何其他條件後，建議分派股息。

於深圳證券交易所創業板上市

自2011年5月起，本公司A股於深圳證券交易所創業板上市。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無嚴重違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。就董事所深知，概無有關本公司於深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請聯交所或[編纂]的潛在投資者垂注。中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司未受到中國證券監管部門的任何行政處罰，因此，本公司已在所有重大方面遵守與A股上市相關的法律及法規。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查及中國法律顧問的上述觀點，獨家保薦人並無注意到令其不認同董事就本公司於深圳證券交易所合規記錄所作確認的重大事項。

貿易限制、關稅及制裁

我們經營業務所處監管環境的貿易限制、關稅措施及制裁相關法律（包括出口管制及規管與受制裁或禁運方的交易的規則）適用於行業參與者。近期的中美貿易緊張局勢已導致關稅高企、出口管制及其他針對高科技商品、半導體及電子產品的限制性措施。我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所已告知，我們的產品分類為美國協調關稅表稅目8542，原因是該稅目明確說明其適用於「電子集成電路」，該表述所指恰為我們所售產品，且產自中國的該等產品通常須繳納50%的

概 要

美國關稅，另加根據中美兩國於2025年10月30日達成的貿易協議項下所謂10%的「芬太尼」關稅。於2026年7月24日，美國總統對許多中國產品徵收12.5%關稅，但2026年7月24日行動通知(July 24, 2026 Notice of Action)附件I.A.2第52(b)條及附件II.A指出該新關稅不適用於稅目8542物項，因此，本公司的產品無須繳納該關稅。因此，我們自中國大陸售往美國的產品適用的最新實際關稅稅率為60%。我們認為於往績記錄期間上述關稅制度並無對我們的運營或財務表現造成重大不利影響。我們於中國大陸及香港的附屬公司所作之對美銷售，須繳納上述美國關稅，原因為通過相關銷售出售的產品主要由位於中國大陸的晶圓廠生產，故須繳納該等關稅。於往績記錄期間各期間，該等銷售佔我們總收入不足2%。我們亦獲益於通過我們於中國大陸以外的附屬公司(如美國及台灣地區的附屬公司)的結構性多元化運營。通過該等附屬公司所作之對美銷售無須繳納上述美國關稅，原因為通過相關銷售出售的產品乃由位於台灣地區或中國大陸以外的其他地區的晶圓代工廠生產。我們計劃通過多元化製造及物流佈局、進行選擇性價格調整及加強與經銷商的接洽以於必要時重新設計物料清單，以降低關稅風險，從而緩解該等潛在關稅影響。

此外，我們的芯片乃作為組件，由下游客戶嵌入汽車、工業醫療以及消費領域的各類終端產品，包括汽車電子系統、工業控制及醫療設備以及消費電子設備。倘該等終端產品出口至美國，則可能因其產品類別及原產地而須繳納美國關稅。即使美國關稅適用於我們的下游客戶內置我們的芯片的終端產品(於該等終端產品出口至美國時)，我們認為，該等關稅對我們的業務營運及財務表現造成的任何間接影響目前並不重大，預期日後亦不會構成重大影響，主要原因如下：(i)該等關稅由下游客戶承擔，而非由我們承擔，且於往績記錄期間，並無任何下游客戶要求我們承擔其內置我們芯片的終端產品所涉及關稅；(ii)我們的芯片僅佔下游客戶終端產品總價值的一小部分(例如根據弗若斯特沙利文的資料，我們集成到汽車的存儲芯片價值通常佔有關汽車總值不到1%)，因此，即使下游客戶受該等關稅影響，我們的芯片對該等客戶所構成的成本影響亦不重大；及(iii)事實上，我們的芯片下游應用及終端市場及我們的客戶基礎多元化。

EAR適用於「受EAR規限」的所有物項(如商品、軟件及技術)，不僅包括美國製造的物項或實際位於美國的物項，亦包括特定外國製造商品。非美國製造的物項如符合「直接產品」規則或超過「最低」受管制美國含量，則受EAR規限。此外，根據EAR，相關限制取決於腳註標註是否適用，如適用，則取決於適用哪個腳註。我們於往績記錄期間與實體清單上的供應商開展的各項交易僅涉及腳註5標註或並無腳註標註。腳註5指我們不得交付用於設計或製造集成電路「生產設備」的物項。於往績記錄期間，就任何有關交易，我們僅交付用於集成電路的設計文件，並無交付任何用於設計或製造任何生產設備的物項。

我們向實體清單上的晶圓廠作出的設計文件轉讓並不涉及EAR，原因如下：(i)我們向有關晶圓廠交付的設計文件並非從美國交付；(ii)我們並無在有關晶圓廠獲納入實體清單後向其轉讓受EAR規限的任何物項；及(iii)就腳註5而言，無論如何，設計文件不構成集成電路「生產設備」。

概 要

我們的計算芯片可用於消費電子應用領域，包括安防攝像頭。用於安防攝像頭應用的計算芯片主要通過經銷商銷售。若干中國視頻監控攝像頭及監控技術生產商受制裁、貿易限制及政府採購禁令（統稱為「**限制措施**」）的規限。

美國、歐盟及英國政府已通過以下四種方式實施限制措施：(i)將特定個人及實體加入制裁名單（例如，美國特別指定國民名單、英國制裁名單，以及受歐盟金融制裁的個人、團體和實體綜合名單）；(ii)就美國而言，將若干實體列入**EAR**下的實體清單，致使受**EAR**管制的物項不得交付予該等實體；(iii)基於其技術特性及能力，將特定物項（包括特定芯片）指定為須受更嚴格的出口管制（具體而言，符合**3A090**標準的先進計算及高性能芯片，或專為用作**3A981**所涵蓋的大規模視頻監控設備組件而設計的芯片，或其他受**3A001**項下嚴格出口管制的高性能芯片）；及(iv)就美國而言，根據2019年《國防授權法案》（「**國防授權法案**」）的第889條，禁止美國政府向特定中國公司及其附屬公司採購電信或視頻監控設備。

鑒於我們的產品主要通過經銷商網絡出售，於往績記錄期間我們利用廣泛的經銷商網絡。因此，我們並無直接了解或控制各經銷商的終端客戶的完整清單，這限制了我們全面跟蹤終端客戶或絕對確定我們的任何終端客戶是否受限制措施規限的能力。根據弗若斯特沙利文的資料，芯片設計公司主要通過經銷商銷售其產品乃屬行業常見慣例，因此無法獲得其終端客戶的完整資料。

通過實施下文所述措施，我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無發現任何情況會導致本集團面臨限制措施的風險。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無收到任何相關政府機構就向我們任何終端客戶銷售我們產品發出的任何通知、問詢或警告。我們計算芯片的經銷商確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無我們的計算芯片售予受限制措施規限的終端客戶。此外，由於我們計算芯片的出口分類並不屬於相關政府用於實施限制措施的類別，因此即使在假設任何計算芯片間接轉讓予受有關限制措施規限的終端客戶的情況下，我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問認為我們的潛在制裁風險較低。

儘管我們並無我們終端客戶的完整名單，但我們已實施以下措施管理與限制措施有關的風險：

- (i) 嚴格合約契諾及終端用途控制 — 我們與經銷商的協議載有禁止向受出口及制裁限制措施規限的客戶銷售的合約條款，且我們有權就任何違約行為向經銷商追償；
- (ii) 獨立出口分類及通用產品定位 — 我們持續聘用美國出口管制專家對我們的芯片進行分類，且我們的芯片均不屬於**3A090**、**3A981**或**3A001**類別。我們芯片的出口分類並不屬於美國或其他政府用以實施限制措施的分類。相

概 要

反，我們的產品為通用型、大眾市場產品，應用於消費電子及一般商業場景，僅用於家用攝像頭、可視門鈴或運動相機等基本視頻應用。該等產品不具備用於大規模視頻監控所需的功能；及

- (iii) 技術跟蹤及市場監察機制 — 我們通過植入唯一標識符(UID)實施芯片級序列化，並將出貨資料與經銷商資料庫進行比對，且我們能定期進行市場抽樣調查及成品拆解分析。如集成我們的芯片的成品發生任何制裁相關風險事件，我們將可獲得相關產品、讀取當中集成芯片的UID，識別有關UID相應的生產批次，並將有關批次與我們的出貨記錄進行比較，從而將相關芯片可能經由其發貨的經銷商範圍縮小至幾家經銷商或一批分銷商。

此外，如第889條的適用範圍擴大至禁止美國政府向特定中國公司採購普通視頻監控設備，我們並無依賴任何受NDAA第889條影響的銷售。

經計及上述因素，我們認為限制措施及通過經銷商銷售對本集團造成的風險較低。

美國人士根據最終規則參與[編纂]

根據我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所的分析，由於我們設計集成電路，因此本集團為《聯邦規則彙編》第31編第850部（「最終規則」）（涉及美國人士於中國公司的投資事宜）項下的受限外國人士。集成電路屬於須向美國財政部申報的公開證券交易所外投資類，但有關投資並未被禁止。倘此等收購須以購買公開交易證券形式進行，且美國人士並無獲得任何超出《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(2)條所列適用標準少數股東保障的管治或其他權利，則美國人士將能夠參與i) [編纂]及ii) 收購[編纂]及[編纂]後二級市場交易中的H股，而無須通知美國財政部有關投資。此結論乃基於《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所載的例外情況及有關公開交易證券的交易被剔除於「受限交易」定義之外，該定義原適用範圍涵蓋特定股權收購、具特定特徵的債務融資、合營企業以及非美國集合投資基金的有限合夥人權益。

我們的法律顧問於達致該結論時，已計及美國財政部發佈的《對外投資安全計劃》常見問題（「常見問題」）。根據美國財政部於2025年12月23日發佈的常見問題第X.4條，收購受限外國人士的股權，倘相關證券於收購時屬公開交易證券，則有關收購被視為收購「公開交易證券」，並因而歸入《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所述之例外情況，而不論相關認購或購買協議於何時訂立。據此，我們的法律顧問認為，於[編纂]及[編纂]完成後，美國人士在[編纂]中認購的H股，於該等收購生效時將於聯交所公開[編纂]，而該等H股將據此構成《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所指的「公開交易證券」。因此，美國人士於[編纂]中收購H股屬上述例外情況，且並無導致向美國財政部的任何申報責任。基於相同理由，美國人士收購[編纂]

概 要

後二級市場交易中的H股，因所收購之證券屆時已屬公開交易證券，同樣歸入上述例外情況。我們及我們的法律顧問均無就遵守最終規則向投資者提供意見。任何屬美國人士的投資者應就適用合規規定諮詢其自身法律顧問。

為免生疑問，我們的法律顧問認為，美國人士收購[編纂]項下的H股僅會於[編纂]完成後完成，[編纂]完成時我們的H股將構成《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所指的「公開交易證券」。於完成[編纂]及[編纂]前，我們的H股不會進行公開交易，且有關收購概不會完成。因此，有關收購並無導致向美國財政部的任何申報責任。

單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，本公司由劉強博士、李杰先生及四海君芯各自分別持有約8.37%、3.29%及0.42%。

為維持本集團管理及營運穩定，劉強博士及李杰先生訂立一致行動協議，據此，劉強博士及李杰先生已同意（其中包括）於本公司股東會及董事會會議上投票時採取一致行動。截至最後實際可行日期，四海君芯由青島君品投資合夥企業（有限合夥）（「青島君品」）控制，而青島君品由其普通合夥人拉薩君品企業管理有限公司（前稱為拉薩君品創業投資有限公司（「拉薩君品」））控制。拉薩君品由劉強博士全資擁有。

因此，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及概無根據2024年限制性股票激勵計劃發行額外股份），劉強博士及李杰先生共同將可於本公司股東會行使約[編纂]%的投票權，且[編纂]後劉強博士、李杰先生、四海君芯、青島君品及拉薩君品將構成本公司的單一最大股東集團。詳情請參閱「歷史及公司架構」。

關連交易

本公司已訂立將於[編纂]後構成上市規則第14A章項下持續關連交易的交易。有關詳情，請參閱「關連交易」。

概 要

[編纂]

近期發展及無重大不利變動

於2026年3月31日之後及直至最後實際可行日期，我們的業務營運及發展實現穩步增長。截至2026年6月30日止三個月，我們存儲芯片、計算芯片及模擬芯片的銷量分別為209.2百萬顆、24.8百萬顆及66.4百萬顆。於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，我們的產能、主要產品銷售或訂單履行並未發生任何重大不利變動。

董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況自2026年3月31日以來並無重大不利變動，且自2026年3月31日以來並無發生會對本文件附錄一會計師報告所載資料造成重大影響的事件。